

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2010 年 11 月 25 日(25.11.2010)

(10) 国際公開番号
WO 2010/134335 A1

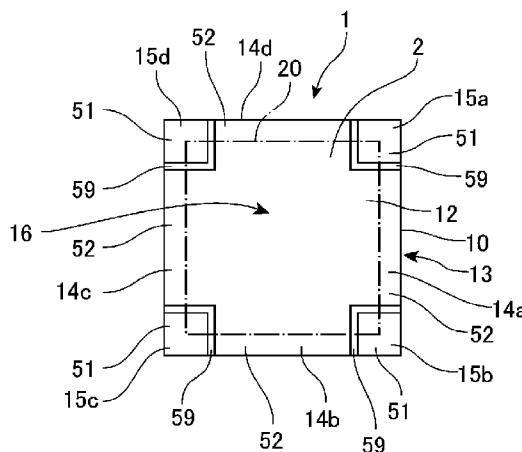
- (51) 国際特許分類:
H01G 9/004 (2006.01) H01G 9/048 (2006.01)
H01G 2/06 (2006.01) H01G 9/14 (2006.01)
H01G 9/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/003373
- (22) 国際出願日: 2010 年 5 月 19 日(19.05.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-121303 2009 年 5 月 19 日(19.05.2009) JP
特願 2009-152193 2009 年 6 月 26 日(26.06.2009) JP
特願 2009-155113 2009 年 6 月 30 日(30.06.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ルビコン株式会社(RUBYCON CORPORATION) [JP/JP]; 〒3994593 長野県伊那市西箕輪 1 9 3 8 番地 1 Nagano (JP). ルビコン・カーリット株式会社 (RUBYCON CARLIT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒3960023 長野県伊那市山寺 1 6 5 番地 Nagano (JP). 日本カーリット株式会社 (JAPAN CARLIT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1010024 東京都千代田区神田和泉町 1 番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮原拓也 (MIYAHARA, Takuya) [JP/JP]; 〒3994593 長野県伊那市西箕輪 1 9 3 8 番地 1 ルビコン株式会社内 Nagano (JP). 柴哲夫 (SHIBA, Tetsuo) [JP/JP]; 〒3960023 長野県伊那市山寺 1 6 5 番地 ルビコン・カーリット株式会社内 Nagano (JP).
- (74) 代理人: 今井彰, 外(IMAI, Akira et al.); 〒3900811 長野県松本市中央 1 丁目 4 番 2 0 号 日本生命松本駅前ビル 8 階 Nagano (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア

[続葉有]

(54) Title: SURFACE MOUNTING DEVICE AND CAPACITOR ELEMENT

(54) 発明の名称: 表面実装用のデバイスおよびコンデンサ素子

[図2]



(57) Abstract: Disclosed is a surface mounting device (1), which has a substrate (10) and a capacitor element packaged on the surface on packaging side of the substrate, and is integrally formed using a resin for housing, with the substrate (10) and the capacitor element included therein. The substrate (10) includes a first terminal electrode (51), which is electrically connected to the first electrode of the capacitor element, and a second terminal electrode (52), which is electrically connected to the second electrode of the capacitor element. At least a part of the mounting side surface (12) on the reverse side of the surface on the packaging side of the substrate (10) is exposed from the mounting surface (2) of the device (1), and the first terminal electrode (51) and the second terminal electrode (52) are disposed in proximity on the entire circumference (13) of the mounting surface (2) of the device (1).

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2010/134335 A1



(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

基板 (10) と、基板の搭載側の面に搭載されたコンデンサー素子とを有し、外装用の樹脂により基板 (10) およびコンデンサー素子を含めて一体に成形された表面実装用のデバイス (1) を提供する。基板 (10) は、コンデンサー素子の第 1 の電極に電氣的に接続された第 1 の端子電極 (51) と、コンデンサー素子の第 2 の電極に電氣的に接続された第 2 の端子電極 (52) とを含み、当該デバイス (1) の実装面 (2) に、基板 (10) の搭載側の面の反対側の実装側の面 (12) の少なくとも 1 部が現れ、第 1 の端子電極 (51) および第 2 の端子電極 (52) が当該デバイス (1) の実装面 (2) の全周 (13) にわたり近接配置されている。